

第 31 期

# 第2四半期報告書

2008年4月1日から2008年9月30日まで

半導体製造装置・高性能精密金型・精密成形品



**TOWA株式会社**

## 株主の皆さまへ

株主の皆さまには、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

ここに、当社第31期第2四半期報告書（2008年4月1日から2008年9月30日まで）をお届けし、ご報告申しあげます。

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融危機に端を発した世界経済の減速に伴う輸出の減少や、急激な為替変動から企業収益が圧迫され、個人消費や設備投資が減退するなど大幅な景気後退がみられました。

また、半導体業界においても半導体需給の悪化やメモリー価格の一段の下落など、半導体メーカーの置かれている状況は非常に厳しく、設備投資計画の延期や凍結が相次ぎました。

このような状況のもと、当社グループにおいても、ユーザーからの納期先送り要請や受注キャンセルが発生し、当第2四半期連結累計期間における業績は、売上高85億27百万円（前年同期比29億33百万円、25.6%減）に止まりました。

また、損益面についても売上高の低迷により、営業損失10億51百万円（前年同期は、営業利益8億3百万円）、経常損失11億16百万円（前年同期は経常利益8億24百万円）、四半期純損失12億38百万円（前年同期は中間純利益8億85百万円）を計上するに至りました。

第2四半期末配当については当初の予定どおり見送りとさせていただきますが、期末配当予想につきましても、誠に遺憾ではございますが、無配に修正させていただきたく存じます。

当社グループといたしましては、ユーザーのニーズにお応えし、新たに開発した量産向けのコンプレッションモールド装置や自社製ダイサーを搭載したシンギュレーション新装置を市場に投入するとともに、当社装置に搭載する超精密金型の生産能力アップのための設備投資や短納期対応体制の充実化を図ることにより、株主の皆さまのご期待に報いるべく、グループ一丸となって業績回復に取り組む所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2008年12月



代表取締役会長



代表取締役社長

坂東和彦 河原洋逸

## トピックス

### 金型の短納期化・生産能力アップのため、九州事業所に第2工場を建設

当社は主力製品である超精密金型の生産能力アップのため、九州事業所の第2工場を建設することといたしました。

これにより、九州事業所の金型生産能力を従来比2倍に拡大し、



台湾などアジアを中心とした需要拡大に対応するとともに、さらなる納期短縮を実現してまいります。



鳥栖市との協定書調印式（2008年10月）

### 新製品の市場投入

一括で樹脂封止した半導体を個々に切り分けるためのシングルーション装置の新機種を発売開始いたしました。

当社独自のモジュール方式採用により、様々な品種に対して、柔軟な対応が可能となりました。



#### FMS（シングルーション新装置）

- ・一括封止工程の需要拡大に対応
- ・自社製ダイサー搭載

半導体チップと基板をつなぐ金線の使用量を6割削減することができるコンプレッションモールド方式の量産向け装置を開発いたしました。

樹脂使用効率の大幅改善など、半導体生産コストの削減に大きく寄与できると、半導体メーカーから注目されております。



#### PMC-S（コンプレッションモールド量産機）

- ・最先端パッケージ向けに開発
- ・従来パッケージにもコスト削減効果大

## 第2四半期決算概要〔連結〕

連結貸借対照表（2008年9月30日現在）

（単位：百万円）

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債および純資産の部】	
流動資産	16,516	流動負債	12,519
現金・預金	3,499	支払手形・買掛金	1,920
受取手形・売掛金	8,143	短期借入金	6,721
たな卸資産	4,606	その他	3,878
その他	266	固定負債	5,523
固定資産	16,101	長期借入金	3,800
有形固定資産	11,900	その他	1,723
建物・構築物	4,838	負債合計	18,043
土地	4,534	株主資本	14,497
その他	2,527	資本金	8,932
無形固定資産	1,078	資本剰余金	3,115
投資その他の資産	3,121	利益剰余金	2,456
資産合計	32,617	自己株式	△ 7
		評価・換算差額等	77
		その他有価証券評価差額金	158
		為替換算調整勘定	△ 81
		純資産合計	14,574
		負債・純資産合計	32,617

(注) 当第2四半期連結累計期間の連結子会社は12社、持分法適用会社は4社であります。

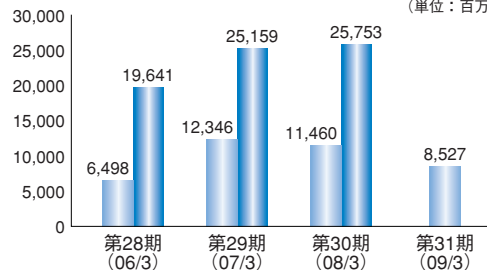
### 連結損益計算書

(2008年4月1日から2008年9月30日まで)（単位：百万円）

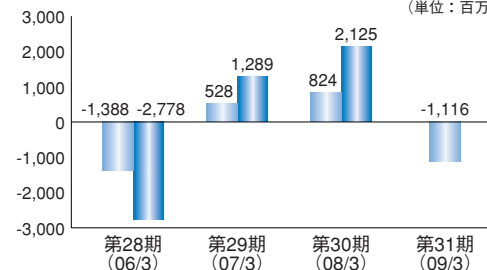
科目	金額
売上高	8,527
売上原価	7,169
売上総利益	1,358
販売費および一般管理費	2,409
営業損失	1,051
営業外収益	115
営業外費用	181
経常損失	1,116
特別利益	10
特別損失	40
税金等調整前四半期純損失	1,147
法人税等	90
四半期純損失	1,238

# 業績の推移〔連結〕

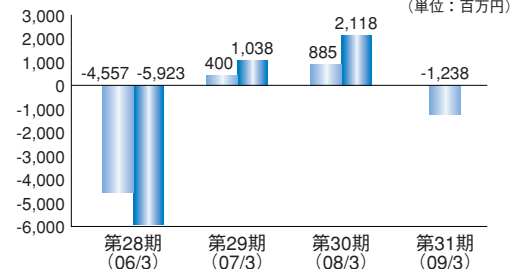
【売上高】 第2四半期累計期間 通期  
(単位：百万円)



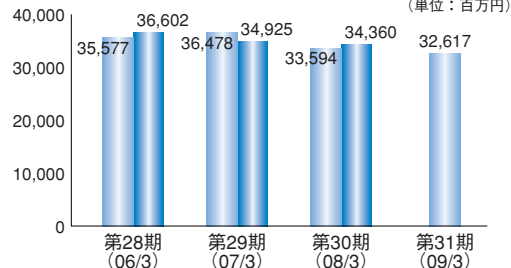
【経常利益】 第2四半期累計期間 通期  
(単位：百万円)



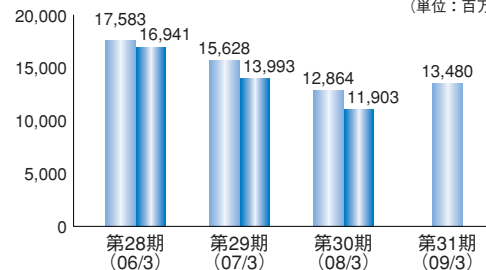
【当期純利益】 第2四半期累計期間 通期  
(単位：百万円)



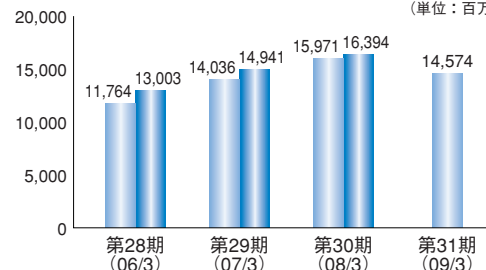
【総資産】 第2四半期会計期間末 通期  
(単位：百万円)



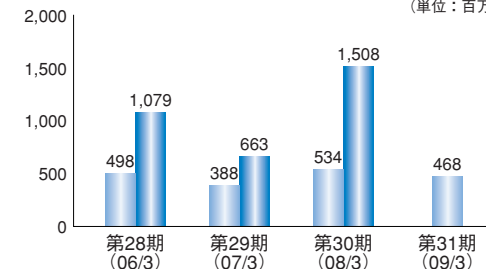
【借入金残高】 第2四半期会計期間末 通期  
(単位：百万円)



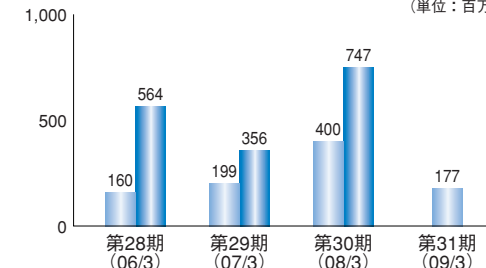
【純資産】 第2四半期会計期間末 通期  
(単位：百万円)



【設備投資】 第2四半期累計期間 通期  
(単位：百万円)



【研究開発費】 第2四半期累計期間 通期  
(単位：百万円)



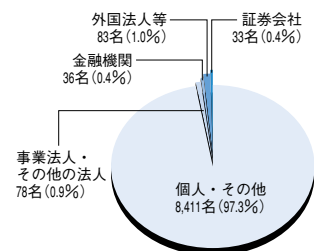
## 株式の状況 (2008年9月30日現在)

発行可能株式総数	80,000,000株
発行済株式の総数	25,021,832株
株主数	8,641名
大株主	

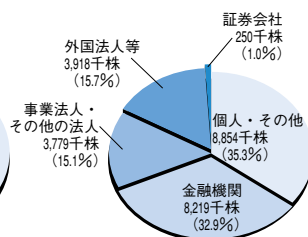
株主名	当社への出資状況	
	持株数	出資比率
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	3,150 千株	12.6 %
坂東和彦	2,093	8.4
(有) ケイビー恒産	2,000	8.0
資産管理サービス信託銀行(株)	1,865	7.5
日本マスタートラスト信託銀行(株)	1,412	5.6
(株) 京都銀行	699	2.8
山田矩規子	501	2.0
(有) ケイビーテクノ	500	2.0
ゴールドマン・サックス・インターナショナル	492	2.0
ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント	423	1.7

(注) 上記の持株数のうち、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)、資産管理サービス信託銀行(株)および日本マスタートラスト信託銀行(株)については信託業務に係る株式数を含んでおります。

### ■所有者別株主数分布



### ■所有者別株式数分布



## 会社の概要 (2008年9月30日現在)

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,932,627,777円
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075) 692-0250 (代表)
役員	代表取締役会長 坂東和彦 代表取締役社長 河原洋逸 取締役専務執行役員 西村永和 取締役常務執行役員 岡田博和 取締役執行役員 福富誠 取締役執行役員 大崎清司 執行役員 岩下昌生 執行役員 小西久二 常勤監査役 白山勉 監査役 杉山公律 監査役 梅山克啓
ホームページ	<a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a>

## TOWAグループ

### ■国内

TOWA株式会社  
本社・工場  
京都東事業所  
坂東記念研究所榎島分室  
九州事業所  
東京営業所  
株式会社バンディック  
TOWATEC株式会社  
TOWAサービス株式会社  
株式会社サーク

### ■海外

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)  
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)  
TOWA Semiconductor Equipment  
Philippines Corporation (フィリピン)  
TOWA America Corporation (米国)  
TOWA Europe GmbH (ドイツ)  
東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)  
上海沙迪克軟件有限公司 (中国)  
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)  
蘇州STK鑄造有限公司 (中国)  
台湾東和半導体設備股份有限公司(台湾)  
巨東精技股份有限公司 (台湾)  
SECRON Co., Ltd. (韓国)  
株式会社東進 (韓国)

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 第2四半期末配当 9月30日
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
同事務取扱場所	大阪市北区曽根崎二丁目11番16号 みずほ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部
郵便物の郵送先	<2008年12月30日まで> 〒135-8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号 <2009年1月5日より> 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話お問合せ先	☎ 0120-288-324 (フリーダイヤル)
取次所	みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 みずほインバスターズ証券株式会社 本店および全国各支店
単元株式数	100株
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL ( <a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a> )
上場取引所	東京証券取引所市場第一部 大阪証券取引所市場第一部

## 株券の電子化について



上場会社の株券は、電子化実施日（2009年1月5日実施）に一齐に電子化され株券が無効になります。

- 株券をお手元（自宅、貸金庫等）にお持ちの場合  
株券の名義をご確認ください。ご本人名義の場合、株主としての権利に影響はありませんが、株券の電子化実施後は、当社が開設する特別口座で管理されます。

### 特別口座とは

株券の電子化に伴い、証券保管振替機構（ほふり）に預託していない株式の権利を保全するために、発行会社が信託銀行等に開設する口座で、当社は、みずほ信託銀行に特別口座を開設いたします。「特別口座」は、株式を売買するための取引口座ではありませんので、そのままでは売却できません。売却等、処分する際には、あらかじめ証券会社等のご本人口座に残高を移す必要があります。

### ■株券電子化実施前

実施前約2週間は証券会社を通じて株券を証券保管振替機構（ほふり）に預けることができないため、株式市場での売却ができません。

### ■株券電子化実施後

実施後約3週間は「特別口座開設手続き」により、証券会社の口座への振替手続きが行えないため、株式の売却ができません。

「株券の電子化」に関するお問合せ・情報は、  
日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター  
(証券受渡・決済制度改革懇談会事務局)  
【株券電子化コールセンター】(月～土9:00～17:00)  
☎ 0120-77-0915 (フリーダイヤル)  
ホームページ: <http://www.kessaicenter.com/>  
「株式のお手続き」に関するお問合せは、  
みずほ信託銀行  
【株主さま専用ご照会ダイヤル】(月～金9:00～17:00)  
☎ 0120-288-324 (フリーダイヤル)  
またはお近くの証券会社へお問合せください。